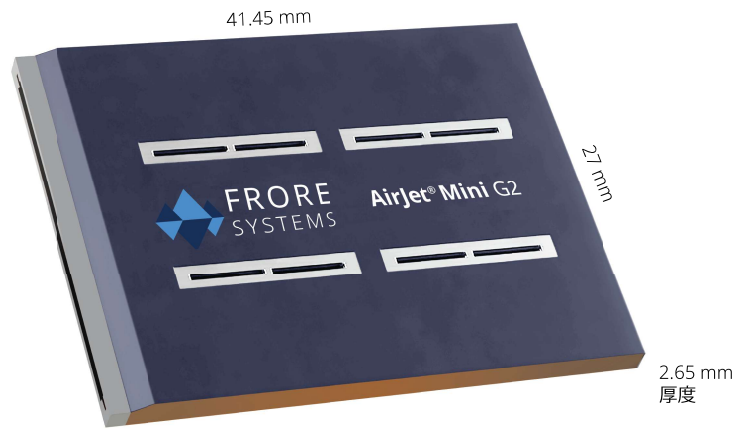




AirJet® Mini G2

强劲 AI 需要能紧跟其性能节奏的散热方案

散热是计算领域的最大瓶颈 —— 而随着先进 AI 模型的兴起，这一问题愈发严峻。AI 推理任务需要的是持续性能，而非短暂爆发。这意味着更多的运算、更多的热量…… 以及对下一代散热方案的迫切需求。

AirJet® Mini G2 横空出世 —— 全球最薄、性能最强的固态主动散热芯片 由 Frote Systems 研发的 AirJet，是一款革命性的全独立主动散热模块。**AirJet Mini G2** 可散出 7.5W 热量，兼具静音、超薄、轻质、防尘、无振动、防溅水等特性，性能超越风扇方案。

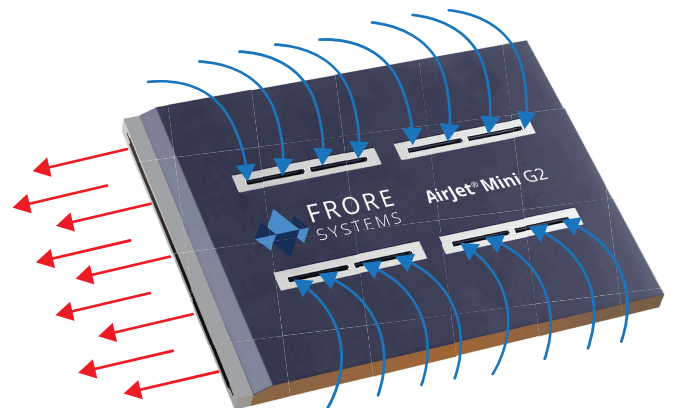
它专为当下高热设备打造 —— 从二合一平板到 5G 热点设备 —— **AirJet Mini G2** 将散热转化为核心竞争优势。

革命性固态冷却技术

与风扇不同，**AirJet** 无任何活动部件。芯片内部的超声 MEMS 振膜吸入空气，产生高速脉冲气流并使其吸收热量，随后热空气通过设备出风口排出 —— 整个模块厚度仅 2.65 毫米。

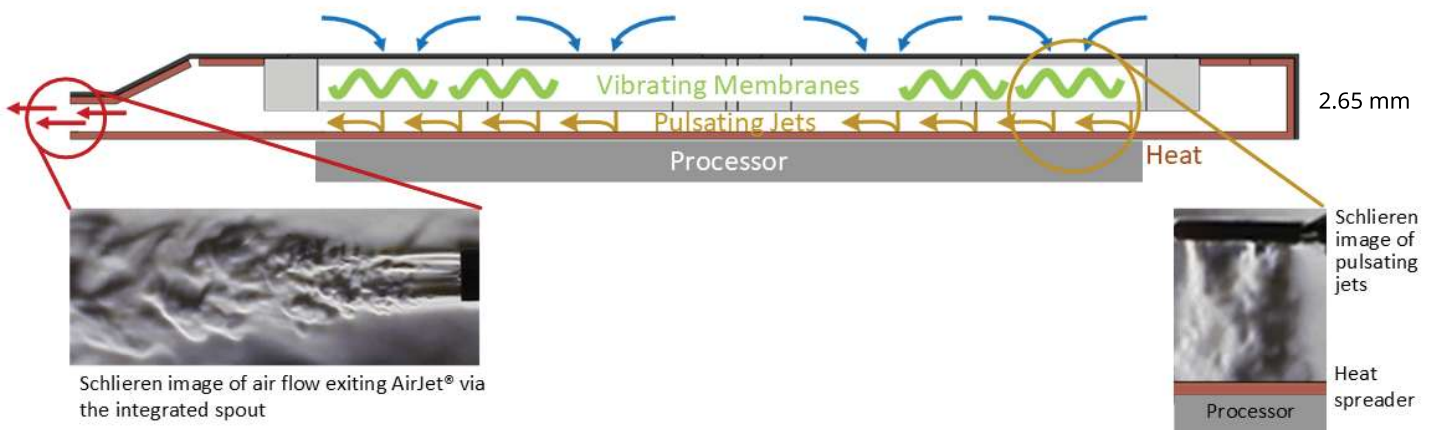
静音•防尘•无振动

AirJet Mini G2 性能不妥协。



AirJet® Air Flow

AirJet 芯片横截面



AirJet® Mini G2

突破性设计

AirJet 的多物理场设计融合了结构、流体、声学、与电谐振特性，其制造采用了自主专利技术，整合了半导体、平板显示、航空航天与汽车等多个领域的工艺。

技术原理

在现代计算中，限制性能的是散热，而非处理器本身的能力。AirJet Mini G2 颠覆了这一逻辑，确保紧凑型电子设备能兑现 “全性能输出” 的承诺。

芯片虽小，背压强劲

AirJet Mini G2 可产生 1750 帕背压 —— 足以在最紧凑的设备外壳（甚至 rugged 嵌入式系统）中驱动气流流通。

防尘？防溅水？轻松应对

AirJet Mini G2 的 1750 帕高背压，可将空气吸入超紧凑型主机设备（即使设备配备了防尘防水滤网）。系统还能安全排出进入 AirJet 的颗粒物，避免堵塞或性能衰减。

小巧设计，无限可能

AirJet Mini G2 厚度仅 2.65 毫米、重量仅 7 克。这一超薄形态为制造商开辟了全新方向，助力其在紧凑设计中实现更高性能。

AirJet Mini G2 可提升超薄设备的性能 —— 覆盖笔记本、平板、手机、固态硬盘、迷你电脑，以及消费级与工业级物联网系统的庞大生态 —— 应用场景横跨数据中心、国防、汽车等多个领域。

AirJet® Mini G2 - 参数一目了然：散热性能无可匹敌，尺寸超薄极致

参数	AirJet® Mini G2
总散热功率 (@ 85C 芯片核心温度, 25C 环境温度)	7.5 W
最大噪音 (设备内部，50cm 处测试)	21 dBA
最大功耗	1.2 W
背压	1750 Pa
Dimensions (宽 x 长 x 厚)	27 x 41.45 x 2.65mm
重量	7 g

超薄·静音·高性能

在消费电子领域，一台 11.7 毫米厚的 14 英寸笔记本，静音模式下的持续处理器功率热限仅 12W；若升级为 4 枚 AirJet Mini G2 模块，同款笔记本可支持 24W 持续处理器功率，仍保持静音运行，处理器性能提升 100%。

工业边缘设备

在工业边缘设备（如机器视觉相机）中，AirJet Mini G2 可显著提升成像质量：将传感器温度从 48°C 降至 15°C，大幅减少会破坏数据完整性、影响良率的扩散暗电流。受尺寸限制，热电冷却器通常仅能将传感器温度降至 30°C；而 AirJet 可将其维持在理想的 15°C，最大化成像质量。

Frore 定律的实践

Frore Systems 正以 “Frore 定律” 驱动散热技术创新 —— 这一宏伟蓝图承诺每两年将散热性能翻倍。

更强性能·零噪音·无振动·无需风扇

Frore Systems 的 AirJet，实现更多。